

2016年5月17日

報道関係者各位

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20

ディーアイシービル

DIC 高周波回路基板などに使用できる低誘電で低吸湿を特徴とする エポキシ樹脂用特殊硬化剤の生産能力を増強 高速通信化が進むアジア圏での需要拡大に備える

DIC株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：中西義之）は、100%子会社DIC北日本ポリマ株式会社（本社：宮城県、社長：古谷英二）において、高速通信化が進むアジア圏での需要拡大に備えるため、高周波回路基板の絶縁材料などに使用できる低誘電かつ低吸湿であることを特徴とするエポキシ樹脂硬化剤を生産する反応釜などの設備を増設しました。このたびの投資により、同社東北工場（宮城県・蔵王町）の生産能力は約1.5倍となり、3月より稼働を開始しています。



DIC北日本ポリマ(株)東北工場

この特殊硬化剤は、反応基にエステル基を導入しているため、従来のアミノ基やフェノール基を有する硬化剤の反応とは異なり水酸基が生成せず、この効果により高周波回路基板にも使用可能レベルの低誘電と低吸湿を実現しています。2015年の発売以来、インターネットの高速通信化に伴い、通信インフラで活用される高度なサーバーなどの基板に使用されています。今後も、高速通信化が進むアジア圏を中心に需要の拡大が見込まれています。

当社グループでは、このたびの増設を受けて同硬化剤の拡販を進め、今年から始まった中期経営計画「DIC108」の最終年度となる2018年に売上高10億円を目指す所存です。

以上